



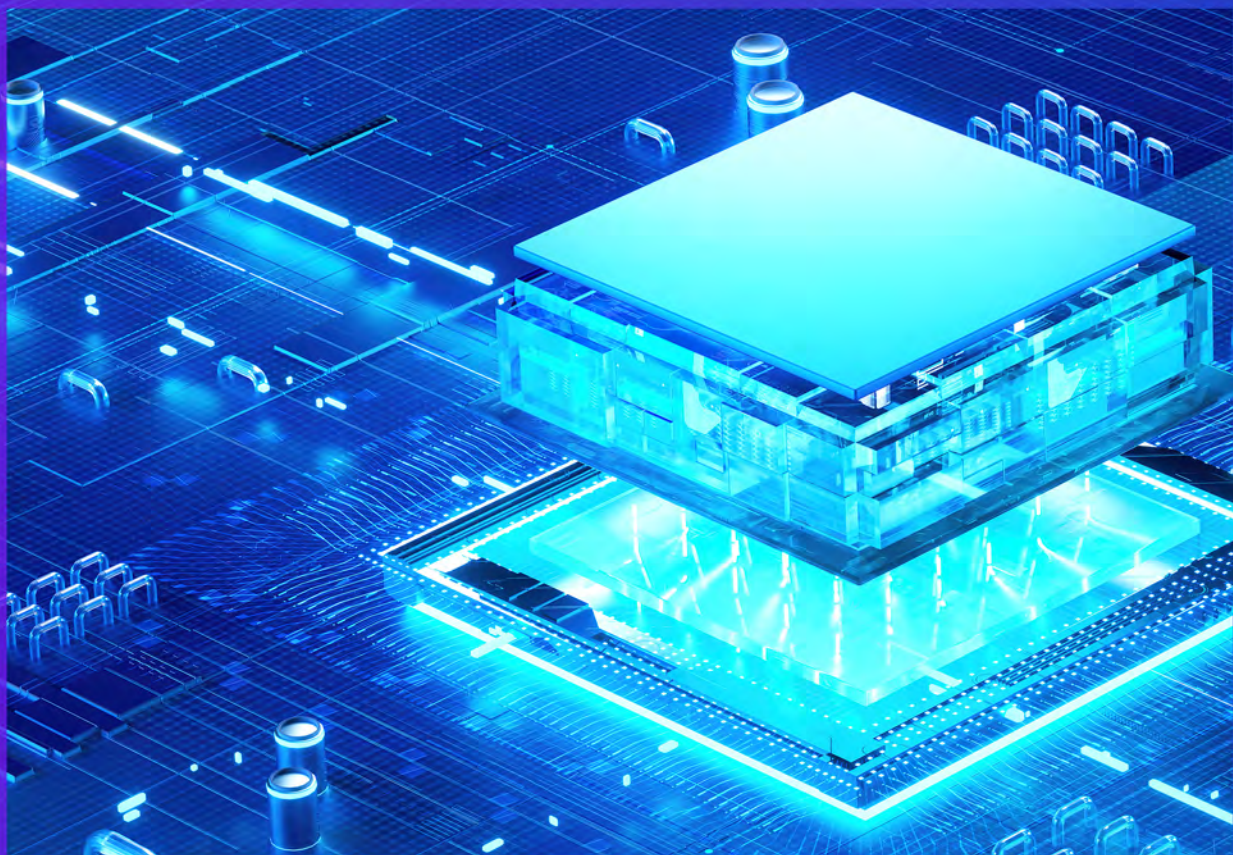
中国“芯科技” 新锐企业50报告(第三届)



毕马威中国未来50榜单系列
KPMG China Future 50 Ranking Series



芯科技
Chiptech



毕马威中国
kpmg.com/cn

关于毕马威	01
卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单地图	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	09
附件一 半导体行业政策法规更新	09
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	11
附件三 毕马威半导体行业洞察	12

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

关于毕马威	01
卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单地图	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	09
附件一 半导体行业政策法规更新	09
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	11
附件三 毕马威半导体行业洞察	12

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

关于毕马威	01
卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单地图	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	09
附件一 半导体行业政策法规更新	09
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	11
附件三 毕马威半导体行业洞察	12

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

关于毕马威	01
卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单地图	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	09
附件一 半导体行业政策法规更新	09
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	11
附件三 毕马威半导体行业洞察	12

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

关于毕马威	01
卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单地图	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	09
附件一 半导体行业政策法规更新	09
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	11
附件三 毕马威半导体行业洞察	12

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。



杨洁

毕马威中国副主席
毕马威中国
华东及华西区
首席合伙人

一年一度的“毕马威中国‘芯科技’新锐企业 50”评选活动已进入第三年，毕马威一如既往地秉持专业、客观、中立的精神，组织推进本届“芯科技”50企业的评选工作。经过近一年的调研、评选、沟通等各项准备工作后，第三届“毕马威中国‘芯科技’新锐企业 50”评选榜单新鲜出炉，如期于进博会期间与大家见面了。

尽管过去几年所面临的行业内外挑战尚未远去，半导体行业忙于应付当前供应链短缺等问题的同时，大多数企业亦致力于细分市场的开拓，部分企业仍在寻求长期资本的投资或兼并扩张。2021年，全球半导体行业的收入再创新高，达到 5,560 亿美元，预计到 2022 年将攀升至 6,000 亿美元。毕马威市场调研显示：受主要终端市场创纪录的需求推动，几乎所有受访者均预期公司和行业收入以及盈利能力在 2023 年会有所提高。“毕马威半导体信心指数”同比增幅创历史新高，这足以反映半导体行业的强劲势头。总体来看，半导体行业的前景依旧值得期待。

本届“芯科技”50企业报名参选企当中既有上两年的“老朋友”，也涌现出行业内兼具创新，稳健且受市场认可的新企业、新面孔。毕马威作为集审计、税务、咨询等业务为一体的专业服务机构与解决方案提供者，设立半导体行业组已逾四年。我们始终致力于为行业内企业提供专业、高效的服务。同时，毕马威也期待能够持续陪伴企业成长，与企业及时代同频共振，为企业和社会不断创造价值。



陈俭德

毕马威中国通信、
媒体及科技行业
主管合伙人

中国数字经济经历了十余年的高速增长，数字化应用场景位于全球主要经济体前列。半导体行业作为数字经济的支柱产业，持续稳健增长。受汽车、通信、人工智能、物联网等下游行业需求的强劲拉动，中国市场对半导体设备的需求已位居全球第一。芯片赛道作为半导体行业的明珠，成为受政策与资本瞩目的焦点。与此同时，受国际地缘因素与各国贸易政策影响，“一芯难求”成为近期半导体行业的主旋律，芯片的国产化替代加速，为不少本土企业同时带来机遇与挑战。

中国半导体设备行业 2021 全年及 2022 年第二季度收入与利润均快速增长，设备厂商在手订单充足，合同负债保持较高增速；半导体材料行业持续突破，随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步完善，在半导体材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产的厂商；半导体封装行业则出现分化，后摩尔时代经济效能提升出现瓶颈，先进封装重要性凸显，核心供应商的市场份额继续增加，护城河效应较为明显。

低制程芯片的生产设备及工艺环境仍是目前制约我国半导体行业领先发展的瓶颈，我国的半导体行业仍然面临着巨大的挑战，芯片国产替代势在必行，国家 2030 计划和“十四五”国家研发计划已经明确将第三代半导体作为重要的发展方向；如何利用好政策和资本杠杆，继续加大研发和创新投入，培养、吸引和保留行业人才，成为行业内企业需要共同研究的重要课题。



李吉鸣

毕马威中国
半导体行业审计主管
合伙人

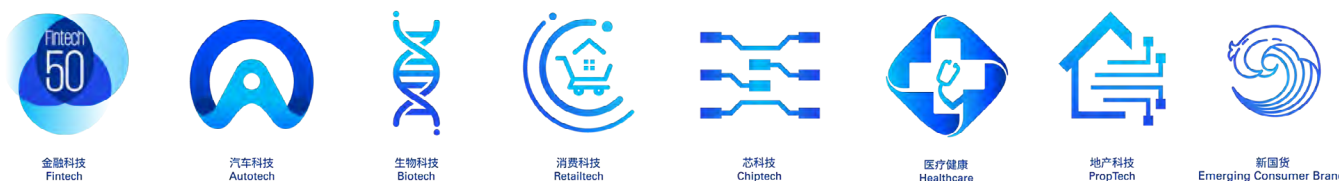
我国半导体设备、材料与零部件行业，受益于国内晶圆厂产线量产，以及国产化进程的发展，相关产品进入密集转销周期；从长远来看，半导体设备、材料仍主要依赖进口，因此国产化前景较为广阔。然而，由于国产化突破面临着“对原材料性能要求高”“后工序处理难度大”“认证体系复杂、周期长”等困难，预计短期内芯片尤其高制成的芯片仍将收到海外产能掣肘，手机及车载芯片产能结构性短缺仍将持续存在一段时间。

得益于国家政策重点鼓励并多方支持国内集成电路及其专用设备产业的经营发展，我国主营或涉及零部件业务的厂商，获得了良好的发展环境，零部件国产化进程正在加快。与此同时，研发创新等内生增长动力和人才资源依然是半导体行业最为重要的资源之一，先进设备研制相对落后和技术型人才短缺并列成为半导体行业在未来数年将面临的首要难题。

我国半导体产业尤其是第三代半导体产业的核心企业，主要分布于长三角（江浙沪皖），环渤海（京津冀鲁），珠三角（广深珠）及川渝等地区。上述地区集聚了较为优质的科研及教育资源，拥有相对优良的营商环境和产业扶持政策，高智力资源和低制度成本可及性更高。同时我们也注意到，上述地区半导体行业的专利申请数，股债融资规模，以及企业并购等资本运作活动显著高于其他地区。因此，毕马威中国在包含上述区域在内的国内重点区域都设有办事机构，以期凭借自身丰富的半导体行业服务经验和广阔的全球资源平台，协助企业把握行业的技术演进路线，洞察资本市场发展机遇。



毕马威中国 “未来 50” 系列榜单



毕马威中国首次推出“未来 50 赛道”的概念，为企业搭建行业赛道，根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。

商场如战场，行业如赛道。自毕马威首次在业界推出“领先金融科技 50 企业榜单”之后，我们持续拓宽赛道，推出涵盖金融、汽车、生物、消费、芯片、医疗健康以及地产等行业的“未来 50”系列榜单。

毕马威“未来 50”系列榜单始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，为企业搭建并拓宽各行业赛道。在此过程中，我们不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。我们希望毕马威“未来 50”榜单成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 介绍

毕马威作为全球知名的专业服务机构，一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在中国芯片领域正带来更多的模式创新和技术创新。

为促进中国芯片领域的发展以及为该领域内企业的成长提供支持，继 2020 年发布首届毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 评选后，毕马威中国设立“芯科技”新锐企业 50 榜单，至今已开启第三届评选活动。

毕马威“芯科技”新锐企业 50 榜单，针对中国芯片领域内致力于推进通信终端及网络、感知系统、数字处理及逻辑运用、物联网实体应用以及半导体材料的高成长

企业，通过线上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质创业企业。

此外，为了加强对创业企业的支持，降低规模及资本对评选结果的影响，本次评选暂不考虑已经上市的公司。本次评选不收取任何费用。

注：

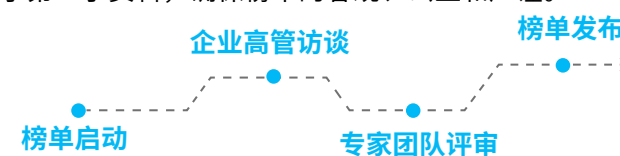
我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。

评委会组成

我们的评审委员会由多领域专家组成，包括：毕马威行业专家及合伙人、中国芯片领域领军企业、半导体协会、人工智能行业联盟，及科研领域的专家学者等。

评选过程

评委实地访谈、调研备选企业，更全面、翔实地掌握了第一手资料，确保榜单的客观、公正和严谨。



参选条件

- 企业在中国芯片领域具有创新性，包括以下五个维度：
 - 通信终端及网络
 - 感知系统
 - 数字处理及逻辑运用
 - 物联网实体运用
 - 半导体材料
- 持续经营 12 个月及以上
- 非上市公司

核心评价维度

- 技术和商业模式的创新
- 估值与资本市场认可
- 半导体行业协会认可度
- 市场认可度
- 财务健康状况
- 团队能力

评选方法

1. 案头调研 (Desktop research)

基于毕马威对芯片设计行业的长期观察，提炼该行业的生态现状

2. 实地访谈 (Field interview)

毕马威中国“芯科技”50 团队对报名企业进行实地走访，访谈企业创始人及高管团队

3. 专家访谈 (Experts interview)

通过对行业领军企业的高管、科研领域的专家与学者等业内专家进行访谈，听取业内人士对行业及细分领域的认知与见解

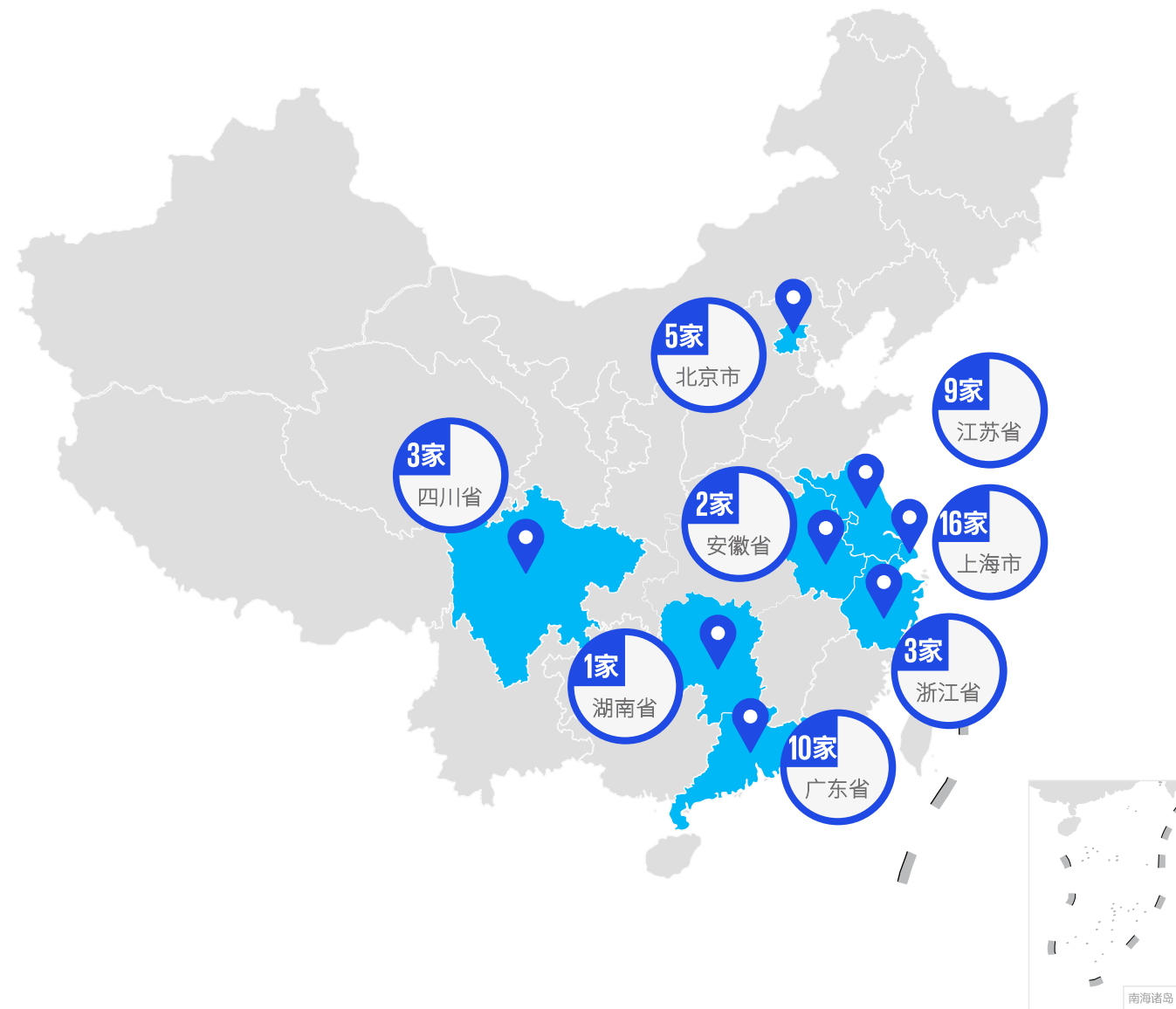
4. 数据模型分析 (Data analysis)

采用毕马威自主开发的创业企业洞察力模型 SIP，对企业进行评估

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 榜单地图

本届上榜企业在地域分布上较为集中：在行政区划上，上海、广东、江苏、北京四省市上榜企业共计 40 家，占比超八成；在城市群区位上，长三角城市群（江浙沪皖）四省市上榜企业共计 30 家，占比超六成，其后分别为大湾区城市群、京津冀城市群及其他地区。

长三角、大湾区及京津冀城市群等区域集中了丰富的科教资源，拥有较为完备的配套产业，行业扶持政策较快较好地落地，使得上述区域成为更多集成电路企业产业布局的首选。毕马威中国在包含上述区域在内的国内多个重点城市都设有办事机构，以期与更多的行业内企业一道洞察资本市场发展机遇。



毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 榜单

企业简称	企业简称	企业简称
埃瓦科技	上海星思半导体	炎黄国芯
博焱视芯	韶光芯材	奕行智能
翠展微电子	深聪智能	益思芯科技
滴翠智能	深迪半导体	涌现科技
光鉴科技	时擎科技	遇贤微电子
后摩智能	视海芯图	元络芯
汇芯半导体	水芯电子	元橡科技
景略半导体	速显微电子	泽丰
聚睿众邦	泰矽微电子	瞻芯电子
鲲云科技	帷肯科技	志行聚能
聆思科技	犀灵视觉	中科驭数
绿展科技	曦华科技	中欣晶圆
模砾半导体	曦智科技	珠海镓未来
墨芯人工智能	芯进电子	珠海星云智联
拍字节科技	芯来科技	SynSense 时识科技
清微智能	芯启源	
荣湃半导体	星逻智能	

* 以上名单按照企业简称首字母顺序排序，排名不分先后。

注：我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。

半导体行业发展趋势

2021 年半导体产业的发展趋势
主要呈现为以下几个方面：

一 全球半导体行业机遇仍大于挑战

受多种终端应用驱动，从智能电动汽车和移动设备到通信基础设施和物联网设备，半导体产品需求量仍然非常巨大。依半导体行业协会指出，2021 年，全球半导体行业的收入再创新高，达到 5,560 亿美元，预计到 2022 年将攀升至 6,000 亿美元。但供应链受到疫情的冲击以及贸易保护政策的持续，许多业内人士认为，“缺芯”潮或将持续一段时间，这将反过来继续影响全球终端市场。纵使供应链面临严峻挑战，这恰好再次凸显了半导体产业对我们生活质量、工作效率和经济发展安全的重要性，因而我们对于半导体行业增长潜力的信心从未如此强烈。

毕马威和全球半导体联盟（GSA）的最新研究发现，为应对未来需求，超半数的半导体受访企业高管（53%）表明其经营策略重点已转向以终端市场为导向，即优先考虑日常业务过

的体制机制障碍，对于更好激发市场主体活力、促进产业转型升级和技术创新、培育壮大经济发展新动能具有重要意义。这给境内包括半导体、集成电路等行业在内的电子电器行业经营者，注入了一剂稳定的强心针。

全球半导体联盟总裁 Jodi Shelton 认为：“得益于我们个人生活和职业生涯中各领域正如火如荼进行着的数字化加速发展，半导体行业的增长和创新水平也达到新高度。自从成为半导体这一关键行业的一分子以来，从未经历过如此振奋人心的时刻。”

二 供给端：行业细分赛道加速分化，半导体零部件成国产化新战场

半导体设备结构复杂，由种类繁多的零部件组成。按照结构组成、设备腔体内部流程和所实现的功能、半导体零部件材料体系、半导体零

件和 LED 技术路线基本成熟并自主可控，有望引领第三代半导体在照明领域的技术革新。

在疫情反复，技术壁垒，国际地区关系趋紧等大环境下，基于自身资源禀赋，谋求差异化发展战略成为我国半导体企业获得竞争优势甚至弯道超车的关键因素。根据国际半导体产业协会（SEMI），2021 年半导体设备销售额 1026 亿美元，同比激增 44%，全年销售额创历史新高，大陆半导体设备市场规模首次在全球市场排首位，达到 296.2 亿美元，同比增长 58%，占比 28.9%。海外供应链断供风险持续存在，晶圆厂采购国产设备意愿较为强烈。

三 需求端：增长热点稳中有变

- 传感器 /MEMS 再次被视为增长潜力最大的产品类别

根据毕马威一项调查的受访者的意见，半导体行业排名第一的增长领域仍然是传感器和 MEMS，这得益于物联网应用、智能手机和可穿戴技术的增加应用，以及汽车行业的需求推动。MEMS 就像是终端产品的“大脑”。随着消费者对产品性能的需求越来越高，这一领域在销售额和创新方面的良好表现使其依旧成为行业焦点，特别是汽车信息娱乐和驾驶辅助系统。

- 应用领域的新秀崛起

在过去几年中，受访者将物联网视为第一收入驱动因素，与无线通信并驾齐驱。展望 2022 年，无线通信保持第一，汽车位列第二，而物联网回落至第三。这一动向反映了整个半导体领域中的热点和最新趋势，如 5G 的升温以及半导体在汽车安全、信息娱乐、工业自动化和自主能力方面的日益广泛应用。在未来的一年里，许多不可或缺的技术将继续为增长注入动力，包括无线通信和 5G、物联网、人工智能和数据中心。与此同时，鉴于半导体公司和汽车制造商之间建立的更多直接联系，汽车行业作为收入驱动力的势头也在增强，虽然汽车制造商受到“缺芯”的重创，但汽车行业的半导体应用被列为第二大收入驱动力。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48650

